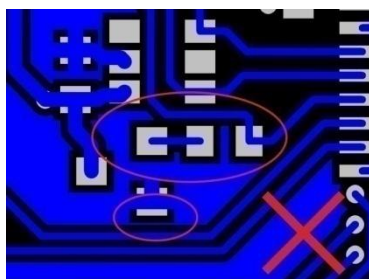


Vodivý obrazec a rozloženie medi.

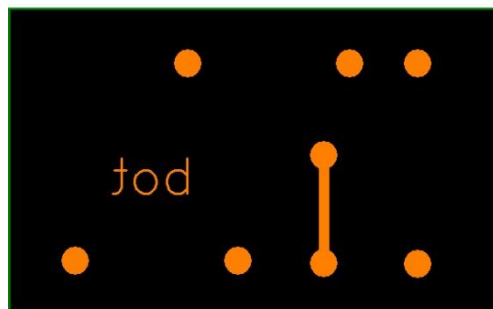
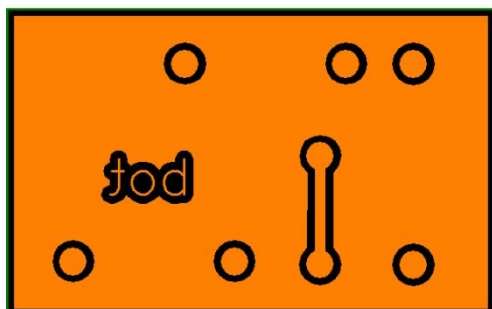
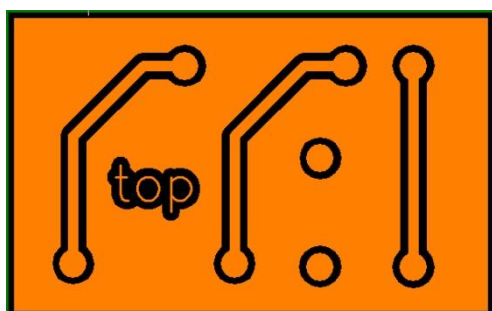
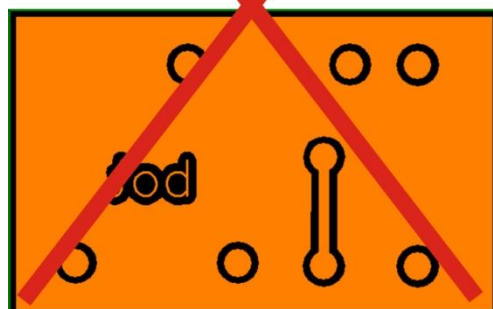
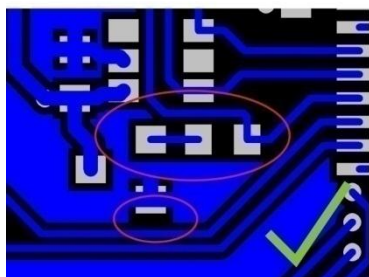
Plochy medi na jednotlivých vrstvách DPS musia byť rovnomerne rozložené. Rozdiel plochy jednej strany voči druhej môže byť maximálne 25%. Väčšia nerovnomernosť plôch spôsobuje nerovnomerné pokovovanie a krútenie základného materiálu. Zemniaca plocha (rozliata med') nesmie byť robená šrafovaním . Odporúčame použiť samostatnú clonku, ktorá nie je použitá pre iný účel. Pri viacvrstvových DPS nie je možné použiť pevné jadrá z rozdielnym plátovaním . Pri nedodržaní týchto pravidiel hrozí deformácia a krútenie materiálu pri neskoršom spracovaní a osádzaní DPS, ktoré sú pri týchto procesoch vystavované vyšším teplotám. Preto pri návrhu DPS striktno dodržujte štandardné normy IPC-600A (Rev. G)

Príklady vyplnenia med'ou 2V DPS

Detail nesprávne rozliatej medi. Medzi smd montážou vznikajú tvary ktoré nespĺňajú podmienky pre výrobu DPS



Upravené miesto



Príklady vyplnenia meďou 4V DPS

